**國家中山科學研究院飛彈火箭研究所**

**107年第四次專案人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類80員、技術生產類76員，共計156員，依「國家中山科學研究院飛彈火箭研究所107年第四次專案人力進用招考員額需求表」辦理(如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)可申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(**持國外學歷者，需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格**)

(一)研發類：

1.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具學校開立證明書認定，或由用人單位自行審查認定。

2.報考人員學歷高於所報考之工作編號學歷需求，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術生產類：

1.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件。

2.報考人員學歷高於所報考之工作編號學歷需求，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：有下列情形之一者，不得進用；若於進用後本院始查知錄取人員有下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之處分者。

**肆、報名時間及方式：**

1. 甄試簡章及職缺需求刊登於本院全球資訊網 (<http://www.ncsist.org.tw>)，公告報名至**107年12月13日止**。
2. 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw) 填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷。
3. 本所於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後，辦理初步選員(資格審查)。
4. 報考人員經初步選員(資格審查)合格者，本所以**電子郵件或簡訊**通知參加甄試。
5. 不接受紙本報名及現場報名。
6. 若為本年度應屆畢業生或延畢生(報名甄試時尚未取得畢業證書者)，報名時請檢附學生證掃描檔供查驗。前述人員於錄取後，需於本院寄發通知日起3個月內(或報到時)，繳驗畢業證書，若無法於時限內繳驗，則取消錄取資格。
7. 歡迎具身心障礙身分或原住民身分且符合報考資格者報名參加甄試，請於人才資料庫登錄資料時及履歷表上註記。
8. 為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳。報考職缺每人最多以三個為原則。**

1. 履歷表：**請依照附件2格式填寫，**並依誠信原則，確實填寫於本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，經查屬實者，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。
2. 符合報考學歷之畢業證書掃描檔。
3. 報考所需之個人相關掃描檔資料(如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等)，請參考簡章之員額需求表。
4. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。
5. 若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附個人社會保險投保證明(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。
6. 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
7. 具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。
8. 本院同仁需繳交經單位主管核章之招考報名申請表掃描檔(如附件3)。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

1. 甄試日期：暫定於**108年1-2月**舉辦(實際甄試時間以甄試通知為準)。
2. 甄試地點：暫定於桃園市龍潭區中科院新新院區(實際甄試地點以甄試通知為準)。
3. 甄試方式：甄試科目及配分請參閱員額需求表

(一)研發類：

1.初試：英文筆試/專業筆試/書面審查/口試初試。

2.口試複試。

(二)技術生產類：

1.實作/筆試。

2.口試。

1. 各項甄試作業如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理的調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
2. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號及手機號碼。若以電子郵件或簡訊通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
3. 研發類筆試或書面審查不合格者及技術生產類筆試或實作不合格者，皆不通知參加口試。
4. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

1. 甄試合格標準：
2. 初試單項(書面審查/筆試/實作/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。
3. 複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)
4. 初、複試總成績合格標準為70分(滿分100分)。
5. 如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。
6. 成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類：總成績為口試複試平均成績。

2.技術生產類：總成績為各單項成績依比例計算後加總。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均(或筆試成績)較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

2.技術生產類：依序以實作平均成績/筆試單一成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

1. 儲備期限：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員，並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉本院院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

1. 甄試結果於甄試完成後一**個月內以電子郵件或簡訊通知，**各職缺錄取情形不予公告。
2. 人員進用：錄取人員參加權利義務說明會後，再辦理報到作業。錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員者，予以資遣並核予資遣費。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

電子信箱：amethyst1219@ncsist.org.tw

總機：(03)4712201

聯絡人及分機：李日新副組長352229

丁樂珍小 姐352232

藍巧茹小 姐352026

沈陞豪先 生352478

附件1

| **國家中山科學研究院飛彈火箭研究所107年第四次專案人力進用員額需求表** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作编號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作地點** | **甄試**  **方式** |
| 1 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空/工業工程 | 1.學歷需符合下列資格條件之一：  (1)機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力/飛機/冷凍空調等理工系所畢業。  (2)工業工程系所畢業，需曾修習工程圖學相關學分或具機械製圖等相關專長訓練 (請檢附證明資料)。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具有專案管理/系統 工程/生產管理相關工作經驗。  (2)具備MS Office軟體 (含Project)操作能 力。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.飛彈/火箭及相關武器系統裝備的研發/生產和後勤之系統整合，以及硬品產製規劃和管制。  2.專案計畫系統工程及計畫管理之推動與管制。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 2 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 工業工程 | 1.工業工程/工業管理/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理/研發管理/生產管理/品質管理等工作經驗1年(含)以上。  (2)具各項專案管理技能檢定成績或證照者。  (3)英文說寫流利。 | 專案管理/生產管理/國際行銷/產業分析/新創公司等，協調/分析/規劃/整合/決策/推動等工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 3 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/能源/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具推進相關研發工作經驗為佳(請檢附證明資料或推薦函)。 | 1.各型火箭發動機之研發，包括設計/測試/分析等工作。  2.系統工程包括系統規劃/分析，介面協調/整合等工作。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 4 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/應用力學/動力/土木/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械設備設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  (2)具結構與機構之動/靜態設計/分析或試驗背景及CAD/CAE 軟體工作經驗。  (3)具高壓氣體管線設計/分析/繪圖工作經驗。 | 1.設備結構/機構/關鍵組件及相關裝備設計/開發/分析或試驗相關工作。  2.高壓氣體管線之管路規劃/設計繪圖/分析與操作相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 5 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/造船/土木/應用力學/機電/系統科學/工程科學/營建/動力機械/車輛/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械結構設計相關工作經驗1年(含)以上。  (2)熟悉下列軟體之一: SolidWorks、Pro/E、AutoCAD。  (3)具結構試驗、量測技術等相關研究或工作經驗1年(含)以上。  (4)具模態測試等相關研究或工作經驗1年(含)以上。  (5)熟悉Famos、Matlab、 LabView、ME’scope (或其他模態測試軟體)等軟體工具之一。 | 至少從事下列工作之一：  1.各型飛彈及水下載具之結構/機構設計開發及系統工程相關工作。  2.載具關鍵組件設計開發及測試。  3.載具結構動/靜態試驗及數據分析。  4.載具機構功能試驗規畫/測試及數據分析。  5.轉動件振動量測及數據分析。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 6 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/電機 | 1.工業工程/機械/電機/電信/電力/車輛/航太/造船/動力機械/土木/應用力學/機電/系統科學/工程科學/光電/電子/系統工程/計算機/輪機/模具製造/自動控制/冷凍空調/能源/通訊/電控/資訊工程/材料工程/物理等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具品質工程/量測檢驗與NI測試程式語言/品保相關經驗證照。  (2)具軟韌體開發/程式語言使用經驗。  (3)具機械或電機檢修能力/檢測機儀器使用能力/電腦軟硬體系統使用或維護能力。  (4)具電力系統測試維護/佈線施工及電力電子訊號量測相關工作經驗。  (5)具ISO品質系統管理經驗。 | 1.執行機械/電機類檢驗與測試/測試設備/測試程序規劃與管制。  2.品質管理作業規劃/管制與稽核。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 7 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航太/造船/系統工程/應用力學/土木/物理/數學等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具計算流體力學等相關領域之研究工作經驗。  (2)具Fluent/ OpenFOAM /STARCCM+等商業軟體使用經驗。  (3)曾修習流體力學/計算流體力學/空氣動力學等相關課程。 | 1.載具外流場計算網格建立及流場數值模擬。  2.載具外型設計及運動性能分析等相關工作。  3.工程軟體開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 8 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具類比、數位電路、單晶片設計經驗  (2)具通訊與數位信號處理經驗。  (3)具FPGA/ASIC設計經驗。  (4)具下列開發經驗之 一：  C++/Linux/Matlab/  LabVIEW/內嵌式程式。 | 1.慣性及衛星接收機導航系統軟硬體開發。  2.DSP/ARM處理器軟體/韌體/硬體開發研製。  3.運用FPGA VHDL/VERILOG等相關語法工具，進行數位電路縮裝開發設計。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 9 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 控制工程 | 1.電機/航太/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單、碩士論文(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)曾修習工程數學與控制工程。  (2)具導航系統設計實務經驗。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.控制系統設計/測試與分析。  2.導航系統設計/測試與分析。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 10 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 控制 | 1.航太/機械/電機/電控/應用力學/工程科學/土木/船舶/數學/物理等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.曾修習或具有下列經驗之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)控制系統分析、設計或模擬。  (2)應用力學及流體力學。  (3)導引律設計、分析或模擬。 | 至少從事下列工作之一：  1.飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。  2.6-DOF Simulation (六自由度模擬)。  3.導引律設計。 | 5員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 11 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械(動機)/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/飛機/工業工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列工作經驗之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)機械類加工製造檢驗。  (2)品質管理/品質管理系統。  (3)實驗室管理。 | 1.精密機械零組件檢驗及相關品質統計及變異分析等品質管理工作。  2.檢驗夾治具設計開發。  3.檢測實驗室品質系統工作執行。  4.執行品質管理系統業務。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 12 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/應用力學/航太/造船/動力/系統工程/機電/土木等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  BT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具Pro/E或Solidwor ks等3D CAD軟體或機械設計能力。  (2)具限元素分析軟體使用經驗。  (3)具機構分析軟體使用經驗。  (4)具液/氣壓系統設計經驗。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 執行機械零組件/機構系統及液/氣壓系統的研發設計/分析模擬/製造/組裝/測試驗證等工作。 | 10員 | 桃園龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 13 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/資工 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程**/**機械等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具下列開發經驗之  一：C++/C#/Java/  Linux/Visual Basic/Matlab/  LabVIEW/內嵌式程式。  (2)具軟體通信與數位信號處理經驗。  (3)具類比、數位電路、單晶片設計經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.軟體/韌體/DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。  2.系統核心設計與測試/系統分析模擬。  3.通訊程式/機構控制軟體開發。  4.類比伺服控制器電路研製/人機操控介面程式設計。  5.電子/電力/通信/系統整合/控制。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 14 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作經驗。  (2)具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。  (3)具linux系統及Qt IDE跨平台程式開發工作經驗。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.DSP或微控制器軟韌體研製。  2.DSP或微控制器或FPGA等嵌入式系統硬體研製。  3.通訊程式/人機操控介面程式或分析軟體設計。  4.系統核心設計與測試/系統分析模擬。  5.測試系統整合設計。  (需配合加班及出差) | 5員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 15 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/控制 | 1.機械/控制/航空/造船/應用力學/機電/系統科學/工程科學等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)機械設計3D CAD軟體（NX、Pro/E、SolidWorks等）  (2)Matlab、LabVIEW、單晶片控制技術及C/C++語言。 | 1.伺服致動器機構與控制系統設計/分析/模擬與測試。  2.執行裝備/系統安裝與測試等相關工作。  (需配合加班及出差) | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 16 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電機/機械/控制 | 1.電機/電子/機械/控制/航空/造船/應用力學/機電/系統科學/工程科學等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)數位電路設計經驗。  (2)熟悉C/C++、Matlab、LabVIEW等軟體。 | 1.電機伺服致動器數位控制設計與測試。  2.執行裝備/系統安裝與測試等相關工作。  (需配合加班及出差) | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 17 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電信/控制/光電/資訊工程/通訊等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具電子/電機/電信/控制/光電/資訊工程相關工作經驗。  (2)具C語言或LabVIEW開發經驗、認證。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.測試器軟硬體開發設計/嵌入式系統應用開發。  2.PXI模組化測試系統研發設計。  3.類比及數位控制電路設計/分析與驗測。  4.電控裝備故障診斷及排除。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 18 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/    PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具C語言或LabVIEW開發經驗/認證。  (2)具電路設計或DSP韌體撰寫等相關工作經驗。  (3)具控制器開發/車載電池系統開發/儲電系統開發/電池測試等相關工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.控制器開發。  2.車載電池系統開發。  3.儲電系統開發。  4.電池測試。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 19 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械結構設計相關工作經驗。  (2)熟悉Pro/E或AutoCAD或SolidWorks 等CAD軟體應用。  (3)具結構有限元素分析相關研究工作經驗。  (4)具固體力學/結構力學/應用力學等相關領域之研究經驗。 | 機構/機械設備總成及零組件設計/分析/3D模型繪製。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 20 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/工業工程 | 1.工業工程/機械/動力機械/車輛/航太(空)/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具下列技術、證照或相關工作經驗1年(含)以上或曾修習相關學科為佳(請檢附證明資料)：  (1)具PDM導入或開發。  (2)具CAD/CAM機械與製程設計、規劃。  (3)具機械類3D電腦輔助設計。 | 1.CAD BOM產品資料管理(PDM)暨3D輕量化圖檔同步工程相關運用。  2.CAD/CAM模組資訊整合暨自動化產製資源管理運用。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 21 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/工業工程 | 1.工業工程/機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具下列技術、證照或相關工作經驗1年(含)以上或曾修習相關學科為佳(請檢附證明資料)：  (1)具產線製程管理規劃或線上生產管理規劃。  (2)具機械設備開發或CAM製程規劃。  (3)具J2EE資料處理。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 產線生產管理/規劃/數據分析等工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 22 | 研發類 | 碩士  畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術或工作經驗。  (2)具機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。  (3)具CAD/CAM製程設計經驗。  (4)具航太零組件設計與機械製造實務經驗。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 武器系統之機械/機構設計/加工/製造及產品製程規劃/生產管制與規劃等工作。 | 7員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 23 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械設計、加工、製造及產品製程規劃等技術或相關工作經驗。  (2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上者。  (3)具CAD/CAM製程設計經驗。  (4)熟悉機械設計Solid Works繪圖軟體。  (5)具液壓設備或組件測試設備開發及測試程式設計規劃撰寫等相關工作經驗1年(含)以上。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械設計/製造及產品製程規劃/研發/產能籌建/測試分析等產製工作。  2.精密液壓組件/超低溫致冷器研發，含籌料/零件製造/組件組裝/總成測試等技術開發。 | 6員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 24 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具Keil C語言開發能力。  (2)具微處理器、DSP、  FPGA等嵌入式系統開發工作能力或經驗。  (3)具類比、數位電路、單晶片設計整合經驗。  (4)具電子電路整合設計能力或經驗。  (5)具電力電子系統整合設計能力或經驗。  (6)具類比、數位電路設計整合經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.航太模組控制軟體/韌體開發。  2.軟體/韌體、DSP數位電路及微處理器軟硬體開發研製。  2.系統核心設計與測試/系統分析模擬。  3.電力電子系統設計與開發。  4.類比及數位控制電路設計/分析與驗測。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 25 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 專案管理/生產管理 | 1.機械工程/工業工程/資訊管理等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理/生產管理/研發管理工作經驗1年(含)以上。  (2)具各項專案管理技能檢定成績或證照者。  (3)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃工作經驗。  (4)熟悉C、C++與Java 語言/資料庫及網頁開發技術。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.負責專案管理/生產管理/研發管理工作。  2.執行規劃/協調/分析/整合/決策/推動/稽核等工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 26 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 工業工程/機械 | 1.機械/航太/機電/自動控制/工業工程/工業管理/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具物料管理/倉儲管理/專案管理或生產管理等資訊整合經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 1.物料管理與專案計畫執行相關系統介面與資訊整合研究。  2.物料進出庫/物流/儲位指派法則建立，物料資訊統計分析研究與管理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **專業筆試**  物料管理。  **參考書籍:**  物料與倉儲管理，作者：洪振創‧湯玲郎‧李泰琳，高立圖書出版社。(60分合格，合格者方可參加口試)  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 27 | 研發類 | 碩士畢業 | 56,650  |  65,000 | 工業工程/機械/航空/物理 | 1.機械/航太/電機/材料/物理/化學/數學/工業工程/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文、期刊)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)曾參與軌道力學/推進系統等相關經驗。  (2)曾參與航太元件設計/分析/試驗等相關經驗。  (3)曾從事專案管理、系統工程管理等相關經驗。  (4)曾從事非半導體之品保規劃/產品或完整系統測試規劃等相關經驗。  (5)曾從事非半導體之大型系統生產規劃與管理等相關經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.系統分析設計/系統工程整合/系統測試等規劃與管理。  2.產品測試與評估。  3.專案管理。  4.專案品保。  5.生產規劃。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 28 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 資訊/專案管理 | 1.資訊/電腦/電子/電機等科系畢業。  2.具下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理1年(含)以上工作經驗。  (2)具J2EE資訊系統開發或資料庫管理等1年(含)以上工作經驗。  (3)具各項專案管理、採購、資訊技能檢定成績或證照者。 | 1.專案計畫之預算管理/進度管制/風險評估等相關業務。  2.J2EE架構之網頁維護/Java與JSP程式撰寫/SQL資料庫資料管理。  3.執行資安檢查/伺服器維護及資訊軟(硬)體維護相關業務。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%**：  Java、SQL語法  **參考書籍：**JAVA SE 9技術手冊  作者：林信良  出版社：碁峰出版社  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
| 29 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 電機/電子 | 1.電子/電機/光電等理工科系畢業。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具丙級(含)以上電機電子類技術士證照。  (2)具室內配線或電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。  (3)具LabVIEW軟體編程與儀器控制能力或經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.執行氣動力試驗儀電模組製作/系統操作與維護工作。  2.執行風洞試驗設備儀電量測線路配接/檢測及儀電系統工作台操作。  3.精密慣性儀具零件製作/組裝測試。  4.執行電池系統安裝、測試及電路測試、繪圖等相關工作。 | 3員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**  錫焊  **實作範圍：**  基礎電路分析/錫焊及功能測試  (70分合格，合格者方可參加口試)  注意：應試者需自備鉗子、電烙鐵、焊錫、數位電表…等工具  **口試40%**  (70分合格) |
| 30 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械/品保/非破壞檢測 | 1.機械/航太/動力機械/機電/電機/應用力學/材料工程/車輛/造船/輪機/土木/工業工程/電腦/通訊/資訊/水利工程/水資源工程/環境工程等科系畢業。  2.其他科系需具下列資格條件之一(請檢附證明資料)：  (1)具非破壞檢測人員證照。  (2)具輻射防護員資格或輻射安全證書執照(或測驗成績及格通知書)。 | 1.銲接件/金屬鑄件及複合材料等硬品道次品保/非破壞檢驗。  2.品質文件資料建立及工件接件/轉出作業。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%**：  非破壞檢測**參考書籍：**  射線檢測法(初、中級)  (財團法人非破壞檢測協會出版)  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 31 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械檢驗/品質管理 | 1.機械/航空/材料工程/輪機/車輛/自動控制/冷凍空調/機電/造船/資訊工程等理工科系畢業。  2.其他科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照及機械相關工作經驗2年(含)以上(請檢附證明資料)。  3.需檢附大學各學年成績單(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械類加工製造檢驗、機械識圖與品質管制/檢驗工作經驗或技術士技能檢定相關證照。  (2)具三次元量床操作及程式撰寫經驗。 | 1.精密機械零組件檢驗/機械性能等檢驗及品質管制工作。  2.執行機械零扣件進料檢驗。  (需配合加班及出差) | 5員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  機械視圖與品質管理  **參考書籍:**  1.品質管制  (中興管理顧問公司發行劉振譯)或一般品質管制書籍  2.幾何尺寸與公差(中央圖書出版社 許兆年、詹安仁、 林榮慶編譯)  3.抽樣檢驗  (中華民國品質學會張有成編著)或其他抽樣檢驗書籍  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 32 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 物料管理 | 1.商經/國貿/會計/資訊/電子/電機/控制/機械/資訊/工業工程/航太/電機/機電等相關科系畢業且具物料管理相關工作經驗6個月(含)以上(請檢附證明資料)。  2.其他科系畢業者，需具物料/物流管理相關工作經驗2年(含)以上(請檢附證明資料)。  3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉Excel之資料彙整分析等操作。  (2)熟悉Word文書編輯軟體。  (3)具一噸以上堆高機訓練合格證書。 | 至少從事下列工作之一：  1.物料資料分析/倉儲管理作業。  2.物料管理及採購業務。  3.專案管理/ISO品質管理/資訊設備管理維護等相關工作。  4.生產履歷資料建立與進度管制業務。  5.文件彙整與技術手冊編撰。 | 5員 | 桃園龍潭 | **筆試60%**：  Excel操作  **參考書籍：**  Excel 2013在辦公室管理上的應用  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
| 33 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 生產排程 | 1.機械/工業工程/工業管理等科系畢業。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)行政院公共工程委員會「採購專業人員基礎訓練」證照。  (2)具生產管理、採購作業、專案管理工作經驗1年(含)以上。  (3)具機械製圖軟體使用經驗。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。(如AutoCAD、SolidWorks)。 | 至少從事下列工作之一：  1.生產製造及排程管制/協調。  2.辦理計畫管制業務。  3.生產資料建立與進度管制業務。  4.文件彙整與技術手冊編撰。  5.辦理採購相關業務。  6.協助工程圖形態管制。 | 5員 | 桃園龍潭 | **筆試60%**：  Word 2013、Excel2013  **參考書籍：**  請參考WORD  、EXCEL應用軟體說明  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 34 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 化學/化工 | 1.不限科系。  2.需具毒性化學物質專業技術管理人員合格證書乙級(含)以上(請檢附證明資料)。  3.具物管實務相關經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 1.化學材料庫儲管理，及其他五金料(扣)件庫儲管理。  2.物料系統帳務處理及統計分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  普通化學  **參考書籍：**  普通化學  作者：楊永華等4人  出版社：三民書局  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
| 35 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 機械 | 1.機械/航空等理工科系畢業；其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具渦輪引擎維修或組裝工作經驗。  (2)具機械類鉗工或航空修護工作經驗。  (3)具液壓測試設備或動平衡工作經驗。  (4)具機械零組件採購或物料管理/生產管理實務經驗。 | 1.執行渦輪引擎動平衡、相關零組件之鉗/銑加工修配/組裝與測試工作。  2.協助辦理零組件籌購與物料管理業務。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鉗工及轉動件動平衡  **實作範圍：**  組裝鉗工、  轉動件動平衝  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 36 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 鉗工 | 1.機械相關科系畢業，其他理工科系畢業者，需具機械加工相關丙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.需具下列資格條件之一(請檢附證明資料)：  (1)具機械、飛機、液/  氣壓、發電機及機械設備等維修、組裝或配管相關工作經驗1年(含)以上。  (2)具機械加工(車、銑、  鉗、磨床、模具、鈑金)等操作或相關工作經驗1年(含)以上。  (3)具有機械加工廠採購  管理工作經驗1年(含)以上。  3.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具藍圖視圖或CAD/CAM軟體使用能力。  (2)具精密機械組裝或液/氣壓相關工作經驗。  (3)具起重機和堆高機訓練合格證照。  (4)其他可資佐證符合專 長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.各項機械零組件加工。  2.系統和裝備組裝/維修/安裝/調校/測試等工作。  3.機械硬品委製/設備維修/刀工具等購案作業。  4.液壓系統油管電管彎管製作與維修/保養。  5.執行電機及液/氣壓致動器零組件加工(車/銑/鉗工)及組裝測試。  6.高壓氣體設備系統組測/操作與維護及5000psi以上高壓氣體配管工作。 | 11員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鉗工  **實作範圍：**  組裝鉗工  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 37 | 技術  生產類 | 大學畢業 | 38,110  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電力/控制等理工科系畢業。其他理工科系畢業者，需具電子/電機/電力相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具基本電路設計經驗。  (2)具公/民營機構訓練證照或證明。  (3)具丙級以上電機電子類技術士證照  (4)具有職業安全衛生管理等相關經驗。  (5)具室內配線或電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。 | 1.電路設計/驗測。  2.電機裝備故障診斷及排除。  3.電機裝備系統安裝/測試。 | 1員 | 桃園龍潭 | **筆試60%**：  電機機械  **筆試範圍：**  電機機電、交流電機基本概念；三相感應電動機、直流電機原理及特性  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
| 38 | 技術  生產類 | 大學  畢業 | 38,110  |  45,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/車輛/繪圖/電腦輔助設計等理工科系畢業。  2.其他理工科系畢業者，需具機械加工相關工作經驗2年(含)以上 (請檢附證明資料)。  3.具有下列資格條件之 一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械相關乙級(含)以上技術士證照。  (2)具三噸以上固定式起重機和一噸以上堆高機訓練合格證書。  (3)具機械設計相關工作經驗。  (4)熟悉Pro/E、AutoCAD、CATIA、NX或SolidWorks 等CAD軟體。  (5)具全民英檢、TOEIC、托福等相關英文成績證明。  (6)具機械加工相關工作經驗1年(含)以上。 | 至少從事下列工作之一：  1.3D/2D機構/機械零組件設計/圖檔整合及3D模型/工程圖繪製。  2.機械設備組立/操作。  3.機械加工夾治具設計與繪圖。  4.Bom表建立與相關工件管理籌獲。  5.各類CAD工具之3D圖檔整合、輕量化3D模型視覺化組立運用與CAD/CAM轉換之3D圖資編修作業。  6.馬達柱塞泵驗收測試/現場機械組裝測試。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  AutoCAD Inventor或SolidWorks軟體操作  **實作範圍：**  3D模型及工程圖製作  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
| 39 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 銲接 | 1.機械/電子/電機等理工科系畢業；其他理工科系畢業者，需具銲接相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.需同時具備下列資格條件(請檢附證明資料)：  (1)氬氣鎢極電銲單一級(含)以上技術證照。  (2)具銲接工作經驗1年(含)以上。 | 1.鋁合金或不銹鋼工件銲接。  2.碳鋼或鉻鉬鋼材料銲接。  3.鈦合金與鎳基合金等材料銲接。  (須配合輪班作業) | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  銲接  **實作範圍：**  鋁合金或不銹鋼或碳鋼銲接  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 40 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 鈑金 | 1.機械/鈑金/冷作等理工科系畢業；其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具鈑金/冷作相關丙級(含)以上技術士證照。  (2)具鈑金或冷作工作經驗2年(含)以上。 | 1.鈑金折彎/旋壓及捲製成型工作。  2.各種材料捲管/修配與整型工作。  3.電控系統箱櫃/車廂製作/修改與組裝工作。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鈑金或冷作  **實作範圍：**  鈑金展開技術  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 41 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 車床 | 1.機械科系畢業；其他理工科系畢業者，需具CNC或傳統車床乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具操作車床加工經驗或曾於公立職訓中心受訓。  (2)具製程規劃與藍圖視圖能力。  (3)具CNC或傳統車床乙級(含)以上技術士證照。 | 1.武器系統各機械零組件車床加工等相關工作。  2.複合材料工件車床加工。  3.CNC車床加工程式撰寫等相關工作。 | 8員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  車床實作  **實作範圍：**  傳統或NC車床加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 42 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 銑床 | 1.機械科系畢業；其他理工科系畢業者，需具CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具操作銑床或電路板製作加工經驗1年(含)以上。  (2)具製程規劃與藍圖視圖能力。  (3)具CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照。 | 至少從事下列工作之一：  1.武器系統各機械零組件銑床加工等相關工作。  2.複合材料工件銑床加工。  3.CNC銑床加工程式撰寫等相關工作。  4.計畫專案生產作業。  5.機械模夾具加工。 | 13員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  NC銑床實作  **實作範圍：**  手寫NC程式並輸入機台控制器執行加工  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 43 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 銑床 | 1.機械科系畢業；其他理工科系畢業者，需具CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具操作銑床或電路板製作加工經驗1年(含)以上。  (2)具CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照。 | 1.電路板鑽孔製程/電路板成型製程加工。  2.散熱片銑製。  3.機械模夾具加工。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  銑床  **實作範圍：**  NC銑床加工(70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 44 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 鉗工 | 1.機械科系畢業，其他理工科系畢業者，需具機械相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2.需具機械加工相關工作經驗1年(含)以上(請檢附證明資料)。  3.具鉗工、氬氣鎢極電銲單一級(含)以上技術證照為佳(請檢附證明資料)。 | 濕硬銲(銲接)機械零件加工/組裝。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  機械零件組裝  **實作範圍：**  濕硬銲機械零件組裝  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 45 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 後勤補給 | 1. 不限科系。 2. 需具鍋爐相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。   3.具管路維護能力為佳。 | 柴油鍋爐操作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**  鍋爐操作；蒸氣管路維護  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 46 | 技術  生產類 | 高中(職)畢業 | 30,900  |  37,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料/汽修等理工科系畢業且具噴漆相關工作經驗1年(含)以上;其他科系畢業者，需具噴漆相關工作經驗3年(含)以上(請檢附證明資料)。  2.具相關技術證照者為佳(請檢附證明資料)。 | 表面處理噴漆作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  噴漆作業（試片噴漆）  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分及格) |
| 47 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工等理工科系畢業；其他理工科系畢業者，需具化學/化工相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  2具表面處理-電鍍及鋁合金陽極處理作業經驗者為佳(請檢附證明資料)。 | 電鍍作業/鋁合金陽極處理作業。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  電鍍作業  **實作範圍：**  電鍍鎳實作(70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 48 | 技術  生產類 | 專科  畢業 | 36,050  |  42,000 | 車床 | 1.機械相關科系畢業。  2.其他理工科系畢業者，需具機械加工類相關乙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  3.非理工科系畢業者，需具機械加工類相關乙級(含)以上技術士證照及機械相關工作經驗一年(含)以上。(請檢附證明資料)。  4.具車床技術士證照為佳(請檢附證照影本)。 | 精密另件之傳統或CNC機具(車床、銑床)加工等相關工作。 | 1員 | 桃園龍潭 | **實作60%：**  中小車床實作  **實作範圍：**  傳統或CNC車床加工  (70分合格，  合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
| 合計：研發類80員、技術生產類76員，共計156員。 | | | | | | | | | |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 自述(本表若不敷使用請自行延伸) |
|  |

　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修，如未檢附者，視同資格不符**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

1. 其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | | |  | | | | | | | |
| **2** | ★**報考職類** | | | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 | | | | | | | |
| **3** | ★**報考項次**  **(報考至多3個職缺為原則)** | | |  | | | | | | | |
| **4** | **前一份工作月薪** | | | 元 | | | **前一份工作年薪** | | 元 | | |
| **5** | ★**預期月薪** | | | 元 | | | ★**可接受最低月** | | 元 | | |
| **6** | **語言能力** | | |  | | | | | | | |
| **7** | **專長** | | |  | | | | | | | |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 計畫名稱 |  | | | 期程 | 至 | | 本院合作單位 | | |  |
| **9** | **證照** | | | | | | | | | | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **碩士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.2** | **博士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.3.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 發表期刊名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.4.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 研討會名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.5** | **其他著作** | | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | |
| 10.5.1 | 著作名稱 | |  | | | | | | | | |

(本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。